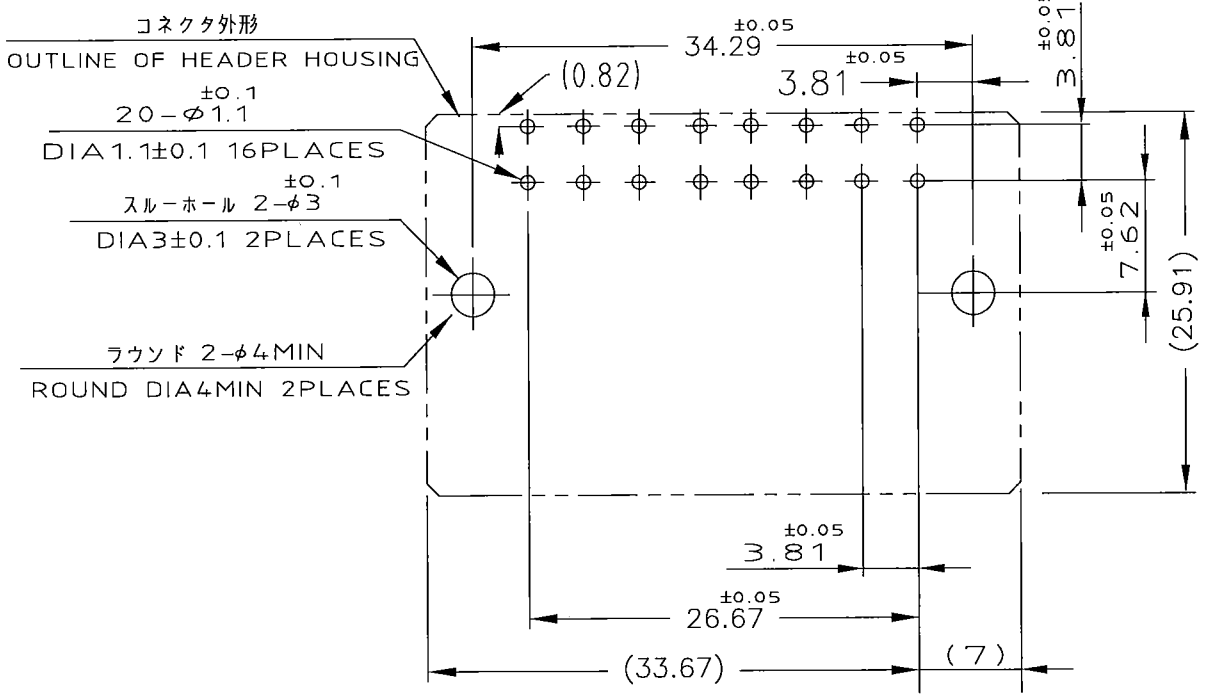
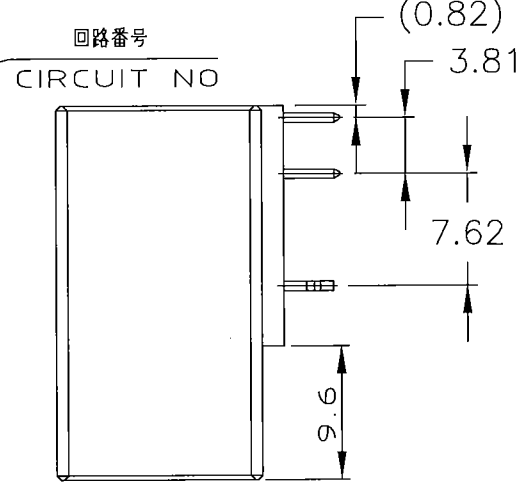
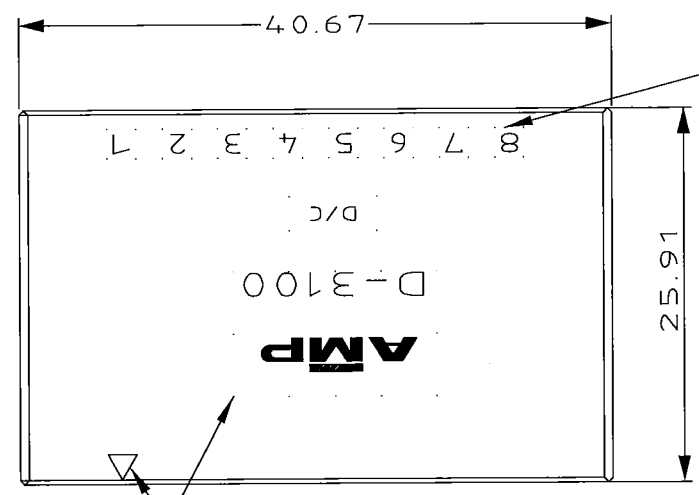
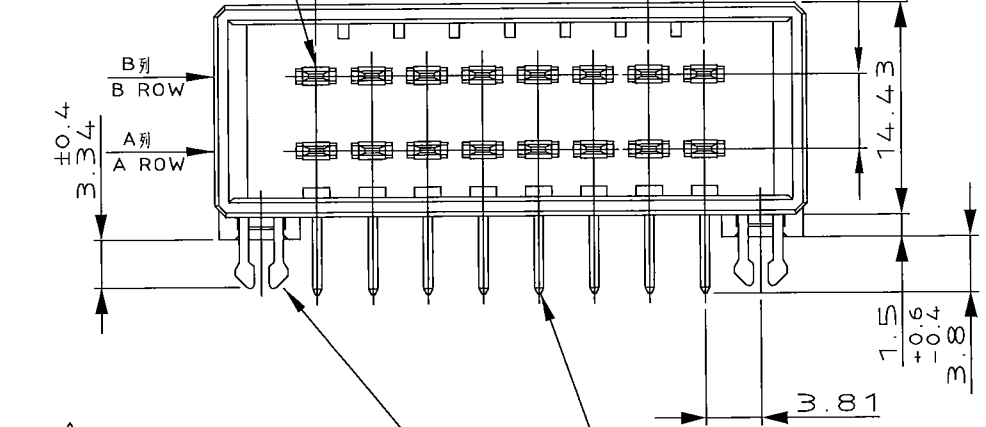


LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		DI REVISED,	28JUL2016	N.W	X.X



回路マーク1  
 CIRCUIT No.1 MARK  
 AMPマーク  
 シリーズマーク  
 SERIES MARK

タブコンタクト  
 TAB CONTACT



リテンションレグ  
 RETENTION LEG  
 コンタクト半田付部  
 CONTACT TAIL

推奨基板取付け穴寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- GENERAL TOLERANCE  
 10 ≥ : ±0.3  
 30 ≥ > 10 : ±0.4  
 100 ≥ > 30 : ±0.45  
 ANGLE : ±3°

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒  
 コンタクト: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき
- 一般公差  
 10 ≥ : ±0.3  
 30 ≥ > 10 : ±0.4  
 100 ≥ > 30 : ±0.45  
 角度 : ±3°

△6	△4	178307-6
△6	△4	178307-5
△6	△3	178307-3
△6	△2	178307-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.IKEDA 16.MAR.95	<b>STE</b> TE Connectivity
		CHK S.Manabe 23.MAR.95	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD K.Ikeda 13.MAR.95	NAME
	0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±-	PRODUCT SPEC	16 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100
MATERIAL SEE NOTE	FINISH SEE NOTE	APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
		WEIGHT -	A3 00779 C-178307
CUSTOMER DRAWING			SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV D1